**2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛**

**邀请函**

创“芯”发展，制造未来

**尊敬的受邀单位：**

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动高质量发展，促进制造强国建设，经国务院批准， 2019年世界制造业大会于今年在合肥举办。

集成电路产业高峰论坛作为世界制造业大会的一项重要内容，将于9月21日上午在合肥天鹅湖大酒店举办，本次论坛以创“芯 ”发展，智造未来，为主题将开展主题演讲、成果发布、高峰对话等一系列活动，全面展开合肥市余国内外半导体产业的深度合作，共同探讨集成电路产业发展的新趋势，届时国家部委，省，市政府，国内外半导体领域知名企业家，著名学者、行业组 织负责人等共同出席，论坛讲为参会各方提供一个交流合作共享的开放平台。

诚挚邀请您拨 出席2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛！

2019年9月8日

**2019世界制造业大会集成电路产业**

**高峰论坛活动议程**

**时间：2019年9月20-21日**

**地点：中国•合肥•天鹅湖大酒店•国际厅（合肥市蜀山区政务文化新区888号）**

**大会议程：**

**9月20日（星期五）：全天报到&交流晚宴**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **议题** | **主持嘉宾** |
| 17:00-19:00 | 交流晚宴 | 省、市领导会见重要参会嘉宾并共进晚餐 |

**9月21日（星期六）：高峰论坛**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **议题** | **拟邀嘉宾** |
| **(一) 开幕式** | | |
| 08:30-08:40 | 致辞 | 安徽省、合肥市领导 |
| 08:40-08:50 | 致辞 | 工信部领导 |
| **(二) 主题演讲** | | |
| 08:50-09:10 | 中国工程院院士倪光南演讲 | 中国工程院院士 倪光南 |
| 09:10-09:30 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武演讲 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁  丁文武 |
| **（三）成果发布和揭牌仪式** | | |
| 09:30-09:50 | 发布《中国半导体产业发展报告》 | 赛迪顾问副总裁 李 珂 |
| 09:50-09:55 | 国家“集成电路创业投资服务联盟”揭牌仪式 | 待定 |
| **（四）主题演讲** | | |
| 09:55-10:15 | 中国存储器产业生态和发展之路探索 | 合肥长鑫存储有限公司董事长 朱一明 |
| 10:15-10:35 | 创新服务中国集成电路设计业发展 | 新思科技全球副总裁 葛 群 |
| 10:35-10:55 | 功率半导体产业发展前景及机遇 | 华润微电子有限公司常务副董事长 陈南翔 |
| 10:55-11:15 | 封装测试企业的国际化发展探索 | 日月光副总经理 郭一凡 |
| **（五）高峰对话** | | |
| 11:15-12:00 | 合肥市集成电路创新发展与挑战 | 主持人：中国半导体行业协会专家委员会主任陈贤 |
| 对话嘉宾：合肥市半导体行业协会理事长陈军宁，中微半导体副总裁曹炼生、芯原微电子董事长戴伟民、通富微电子董事长石磊、地平线创始人&CEO余凯、合肥晶合董事长陆炜 |

**2019世界制造业大会集成电路高峰论坛**

**报名回执表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | 邮编 |  |
| 通信地址 |  | | | |
|  | 参会人员1 | 参会人员2 | 参会人员3 | |
| 姓名 |  |  |  | |
| 部门 |  |  |  | |
| 职务 |  |  |  | |
| 电话 |  |  |  | |
| 手机 |  |  |  | |
| Email |  |  |  | |
| 联系人：李文  电话：15510708156  邮箱：[zuweihui@ccidconsulting.com](mailto:zuweihui@ccidconsulting.com)  地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层（100048）  本次活动不收取任何费用，本表格复印有效，请于9月18日前将回执表通过邮件回复至会务组  以便组委会做好各项工作。 | | | | |